

# 6-Zoll-Ptfe-Wafer-Reinigungsrahmen Für Nassätzen, Säure- Und Alkalibeständig, Fluoropolymer-Wafer-Träger

Artikelnummer: PL-CP421



## Einführung

Hochreine 6-Zoll-PTFE-Wafer-Reinigungsrahmen, entwickelt für aggressive Nassätzprozesse. Diese säurebeständigen Fluoropolymer-Träger bieten außergewöhnliche chemische Stabilität und ultra niedrige Kontamination für die Halbleiterfertigung sowie anspruchsvolle Anwendungen in der Spurenanalyse und chemischen Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter-Nassätzen	Verarbeitung von Siliziumwafern in HF-, BOE- oder heißen Phosphorsäurebädern.	Verhindert metallische Kontamination und übersteht aggressive Chemikalien.
Solarzellenfertigung	Reinigung und Texturierung von Siliziumsubstraten für die Photovoltaikzellenproduktion.	Hochvolumen-Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen ätzende Texturierungslösungen.
Spurenanalyse von Metallen	Reinigung von Laborgerät und Substraten vor der ICP-MS-Analyse.	Ultra niedrige Hintergrundwerte und kein Ionenauswaschen für präzise Daten.
MEMS-Fertigung	Handhabung von mikro-elektromechanischen Systemen während der tiefen reaktiven Ionenätzung oder des Nass-Release.	Empfindliche Handhabung mit hoher Dimensionspräzision für fragile Strukturen.
Chemische Gasphasenabscheidung	Vorreinigung von Substraten, um hochwertiges Dünnschichtwachstum zu gewährleisten.	Gewährleistet eine atomar saubere Oberfläche durch Widerstandsfähigkeit gegen Vorbehandlungssäuren.
Pharmazeutische Reinigung	Sterilisation und Reinigung von hochreinen Komponenten in der pharmazeutischen F&E.	FDA-konformes Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Sterilisationsmittel.
Galvanische Prozesse	Halten von Substraten während der präzisen Metallabscheidung in Säure- oder Alkalibädern.	Elektrische Isolation und vollständige Beständigkeit gegen Galvanik-Elektrolyte.

Spezifikationskategorie	Details für PL-CP421
Modellnummer	PL-CP421
Basismaterial	Hochreines Virgin-PTFE (PFA/TFM auf Anfrage verfügbar)
Primärer Waferdurchmesser	6-Zoll (150 mm) Standard
Wafer-Kapazität	Vollständig anpassbar (z. B. 25-Slot, 50-Slot oder benutzerdefinierte Anzahlen)
Schlitzbreite/-teilung	Anpassbar an Substratdicke und Abstands Anforderungen
Griffdesign	Fest, abnehmbar oder erweitert (Angepasst an Baddicke)
Temperaturbeständigkeit	-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
Fertigungsmethode	5-Achsen-Präzisions-CNC-Fräsen
Oberflächenbeschaffenheit	Ra < 0,8 µm (typisch) oder angepasstes Polieren
Chemische Verträglichkeit	Universell (Außer für geschmolzene Alkalimetalle und elementares Fluor)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Spezifikationskategorie	Details für PL-CP421	
Konformität	Halbleiter-Qualität / Spurenanalyse-Qualität	